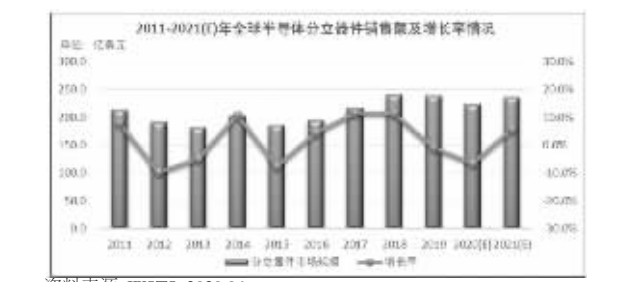


杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A46 版)



资料来源:WSTS,2020.06

受益于国家产业政策对新兴产业的大力支持和对传统行业的升级改造,我国分立器件行业市场规模稳步增长,销售收入占全球比重逐年上升。

根据中国半导体行业协会统计,2018年我国分立器件行业(该分类还包括光电器件、传感器)的销售收入为2,716亿元,同比增长9.79%。

4)公司在分立器件市场的竞争地位未发生重大不利变化

我国分立器件行业起步较晚,主要通过国外引进和国内企业自主创新,逐步提升行业的国产化程度,满足日益增长的下游需求。

根据中国半导体行业协会统计,公司在2017年中国分立器件行业十强企业评选中位列第八名。

3、公司主要指标与2019年主要经营业绩变动原因

Table with 4 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 同比增减. Rows include 营业收入, 营业毛利, 管理费用, etc.

公司2019年度业绩下降的主要原因系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加。

2019年,发行人研发费用较2018年增加1,038.01万元,研发费用率上升至8.14%。

2019年,发行人财务费用较2018年增加2,995.81万元,财务费用率上升至7.55%。

报告期内,研发费用持续上升,主要是由于随着子公司立昂芯和衢州金瑞微的陆续建设及投产。

2) 发行人2019年业绩下滑主要因素的变化情况

1、研发费用 报告期内,研发费用持续上升,主要是由于随着子公司立昂芯和衢州金瑞微的陆续建设及投产。

2、财务费用 报告期内,公司的财务费用持续上升,主要是由于子公司立昂芯和衢州金瑞微的陆续建设及投产。

3、资产减值损失和信用减值损失 报告期内,公司的资产减值损失和信用减值损失均较2018年大幅增加。

4、营业收入 报告期内,公司的营业收入较2018年有所增长,但增幅低于预期。

5、营业毛利 报告期内,公司的营业毛利较2018年有所增长,但增幅低于预期。

6、管理费用 报告期内,公司的管理费用较2018年有所增长,但增幅低于预期。

7、销售费用 报告期内,公司的销售费用较2018年有所增长,但增幅低于预期。

8、其他 报告期内,公司的其他费用较2018年有所增长,但增幅低于预期。

9、净利润 报告期内,公司的净利润较2018年有所增长,但增幅低于预期。

10、净资产 报告期内,公司的净资产较2018年有所增长,但增幅低于预期。

11、总资产 报告期内,公司的总资产较2018年有所增长,但增幅低于预期。

12、其他 报告期内,公司的其他资产较2018年有所增长,但增幅低于预期。

13、其他 报告期内,公司的其他负债较2018年有所增长,但增幅低于预期。

14、其他 报告期内,公司的其他权益较2018年有所增长,但增幅低于预期。

2、发行人的收入规模和综合毛利率水平对持续经营能力的影响分析

(1)收入规模趋势 报告期内,发行人的营业收入分别为93,201.96万元、122,266.70万元和119,168.60万元。

(2)综合毛利率水平 报告期内,发行人的综合毛利率分别为29.98%、37.69%和37.31%。

鉴于发行人已具备一定的生产规模,营业成本相对固定,故发行人产品的销售价格对毛利率的影响更大。

2011年至2019年,全球半导体硅片市场价格波动情况如下图所示:



由上图可见,2017年起,全球半导体硅片市场明显回暖,产品需求持续上升,半导体硅片整体处于供不应求状态。

2019年下半年开始,全球半导体硅片市场景气度在阶段性高点后有所回落,自2020年开始又逐步复苏。

上述半导体硅片行业景气度与半导体硅片市场价格的变化情况与发行人2020年半年度综合毛利率的变化(从2019年的37.31%下降至36.61%)。

综上分析,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3、2019年业绩下滑主要因素对持续经营能力的影响

2019年公司经营业绩大幅下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括8英寸及12英寸半导体硅片、第二代半导体射频芯片及MOSFET芯片等多类产品正处于生产线建设及产能爬坡阶段。

2019年下半年开始,全球半导体硅片市场景气度在阶段性高点后有所回落,自2020年开始又逐步复苏。

上述半导体硅片行业景气度与半导体硅片市场价格的变化情况与发行人2020年半年度综合毛利率的变化(从2019年的37.31%下降至36.61%)。

综上分析,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

14、财务报告审计截止日后的主要经营业绩

公司财务报告审计截止日为2020年3月31日,根据《关于首次公开发行股票并上市申报审计截止日后的主要经营业绩公告》。

公司财务报告审计截止日后主要经营业绩公告,以及财务报表附注进行了审阅,出具了中汇会审[2020]2530号《审阅报告》。

根据我们的审阅,我们并没有注意到任何事项使我们相信立昂微2020年2季度财务报告没有按照企业会计准则的规定编制,未能对所有重大方面公允反映立昂微的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

公司在招股意向书“十一、财务报告审计截止日后的主要经营业绩”中披露了审计截止日(2020年3月31日)后至2020年6月30日期间公司的主要经营业绩。

(一)审计截止日后主要经营业绩

公司2020年1-6月合并财务报表(经审阅,但未发表审计)的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020-06-30, 2019-12-31, 变动比例. Rows include 资产总计, 负债合计, etc.

2、合并资产负债表主要数据

Table with 4 columns: 项目, 2020年4-6月, 2019年4-6月, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业毛利, etc.

注:2019年4-6月数据未经审计,下同。

3、合并现金流量表主要数据

Table with 4 columns: 项目, 2020年4-6月, 2019年4-6月, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, etc.

(二)审计截止日后主要经营业绩

财务报告审计截止日至本招股意向书签署日,公司经营情况稳定,相关产业政策未发生重大调整,进出口业务未受到重大限制,税收政策未出现重大变化。

行业周期性未出现重大不利变化,业务模式及竞争趋势未发生重大变化,主要原材料的采购价格和采购价格或主要产品的生产、销售价格未发生重大变化。

主要客户或供应商未出现重大变化,重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化,未发生重大安全事故,以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

(三)2020年1-9月业绩预计情况

结合半年度经营业绩、公司在手订单情况以及对下游客户的销售预期,公司预计2020年1-9月将实现营业收入93,096.26万元至107,218.36万元。

截至2020年1-9月,公司实现营业收入93,096.26万元,同比增长6.74%至22.93%左右;实现归属于母公司股东的净利润10,959.33万元至12,981.55万元左右。

截至2020年1-9月,公司实现营业收入93,096.26万元,同比增长6.74%至22.93%左右;实现归属于母公司股东的净利润10,959.33万元至12,981.55万元左右。

截至2020年1-9月,公司实现营业收入93,096.26万元,同比增长6.74%至22.93%左右;实现归属于母公司股东的净利润10,959.33万元至12,981.55万元左右。

截至2020年1-9月,公司实现营业收入93,096.26万元,同比增长6.74%至22.93%左右;实现归属于母公司股东的净利润10,959.33万元至12,981.55万元左右。

截至2020年1-9月,公司实现营业收入93,096.26万元,同比增长6.74%至22.93%左右;实现归属于母公司股东的净利润10,959.33万元至12,981.55万元左右。

截至2020年1-9月,公司实现营业收入93,096.26万元,同比增长6.74%至22.93%左右;实现归属于母公司股东的净利润10,959.33万元至12,981.55万元左右。

截至2020年1-9月,公司实现营业收入93,096.26万元,同比增长6.74%至22.93%左右;实现归属于母公司股东的净利润10,959.33万元至12,981.55万元左右。

股份公司成立日期:2011年11月16日

住所:杭州经济技术开发区20号大街199号

统一社会信用代码:91330100736871634P

电子邮箱:liw@li-on.com

2011年11月16日,立昂微电领取了杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号为33019800004201)。

(二)发起人及其投入的资产内容

公司设立时,各发起人及其持股情况如下表:

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例, 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例. Rows include 1 王敏文, 2 宁波波科, etc.

本公司系由立昂有限整体变更设立,上述发起人均以立昂有限的净资产出资。

三、发行人有关股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为36,000万股,本次公开发行新股不超过4,058万股,占发行前总股本的比例不低于10.00%,不超过10.1313%。

有关公司股份流通限制和锁定安排参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺”。

(二)持股数量及比例情况

1、发起人 (1)自然人发起人

33名自然人发起人发起设立股份公司时,共有47名自然人发起人,其中有33名自然人发起人目前仍为发行人股东。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例. Rows include 1 王敏文, 2 宁波波科, etc.

(2)法人发起人 法人整体变更发起设立股份公司时,共有2名法人发起人,分别为宁波波科和上海碧晶。

截至本招股意向书签署日,其持股数量及比例情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例. Rows include 1 王敏文, 2 宁波波科, etc.

(2)法人发起人 法人整体变更发起设立股份公司时,共有2名法人发起人,分别为宁波波科和上海碧晶。

截至本招股意向书签署日,其持股数量及比例情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例. Rows include 1 王敏文, 2 宁波波科, etc.

截至本招股意向书签署日,发行人前十名股东持股数量及比例情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例. Rows include 1 王敏文, 2 宁波波科, etc.

4、国有股份或外资股份

截至本招股意向书签署日,发行人不存在国有股份或外资股份。

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至本招股意向书签署日,发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系如下:

Table with 4 columns: 股东A, 持股比例, 股东B, 持股比例. Rows include 王敏文, 22.11%, 宁波波科, 7.50%, etc.

四、发行人业务情况

(一)发行人的主营业务

发行人主营业务为半导体硅片和分立器件产品的研发、生产和销售,以及分立器件产品的生产和销售。

发行人的子公司浙江金瑞微、衢州金瑞微主要从事半导体硅片业务(不包括12英寸半导体硅片)。

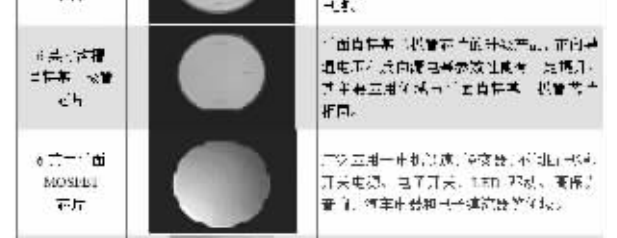
此外,发行人的子公司金瑞微微电子主要从事12英寸半导体硅片业务,立昂微电子主要从事微波射频集成电路芯片业务。

(二)发行人的主要产品及其用途



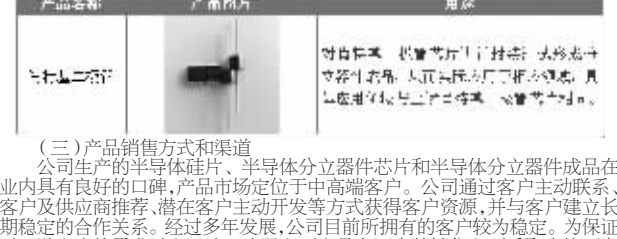
2、分立器件产品

公司分立器件产品主要是肖特基二极管芯片和MOSFET芯片,具体情况如下:



3、半导体分立器件成品

公司半导体分立器件成品主要为肖特基二极管,具体情况如下:



(三)产品销售方式和渠道

公司生产的产品包括半导体硅片、分立器件芯片和分立器件成品,在业内具有良好的口碑。

发行人主要客户包括半导体硅片、分立器件芯片和分立器件成品,在业内具有良好的口碑。

(四)所需主要材料及能源

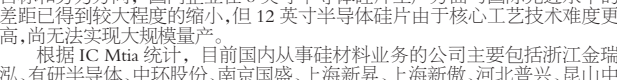
发行人生产所需的主要原材料包括:多晶硅、石英坩埚、硅片、切割材料、抛光材料、外延材料、封装壳、金属颗粒、衬底片、硅外延片等。

(五)行业竞争情况

1、半导体硅片行业竞争情况 (1)全球市场情况

从全球市场来看,半导体硅片市场具有较高的垄断性,少数主要厂商占据了绝大多数市场份额。

2017年全球主要半导体硅片供应商市场份额图



(2)国内市场情况

从国内市场来看,由于我国从20世纪90年代逐步开始加大对半导体产业的投入力度,同国外发达国家相比整体起步较晚。

根据IC MIA统计,目前国内从事新材料业务的公司主要包括浙江金瑞微、有研半导体、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、昆山中辰等十余家。

衢州金瑞微正在建设的集成电路用8英寸硅片项目将增加月产能10万片,中环股份已实现月产30万片8英寸硅片的产能。

有研半导体在12英寸硅片的生产能力,在建8英寸硅片生产线产能将达到15万片。

在12英寸硅片研发与产业化方面,上海新昇12英寸硅片生产线已达产月产能10万片。

发行人负责12英寸硅片产业化项目的子公司金瑞微已在建设年产180万片集成电路用12英寸硅片项目。

重工业集团已建成12英寸硅片生产线,国内8英寸半导体硅片的生产在一定程度上缓解了我国对相关产品进口的依赖。

国内半导体硅片行业主要上市公司的资产规模、销售规模、经营状况及研发水平等方面的情况如下表所示:

Table with 5 columns: 行业类别, 上市公司(简称), 上市代码, 总资产(万元), 营业收入(万元), 归母净利润(万元). Rows include 半导体硅片, 中环股份, etc.

注1:表中数据来源于中环股份2019年年度报告

注2:中环股份营业收入主要来源于新能源材料,包括太阳能硅片等产品;而包含半导体硅片、半导体硅片等产品的半导体材料营业收入为123,739.08万元。

上述公司的研发水平如下:

Table with 4 columns: 行业类别, 上市公司(简称), 上市代码, 研发水平. Rows include 半导体硅片, 中环股份, etc.

注1:上述数据来源于其2019年年度报告

2、分立器件产品行业竞争情况 (1)全球市场情况

全球来看,美国和欧洲半导体分立器件行业目前居于全球领先地位,随后是日本和中国台湾。

国内半导体分立器件行业主要上市公司资产规模、销售规模、经营状况及研发水平等方面的情况如下表所示: